

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

峰昭科技（深圳）股份有限公司  
投资者关系活动记录表

2023 年 5 月

|                 |   |  |  |   |
|-----------------|---|--|--|---|
| 投资者关系<br>活动类别   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 网络会议 | <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 电话会议<br><input type="checkbox"/> 其他 |  |   |
| 参与单位名称          | 平安基金<br>南方基金<br>博时基金<br>鹏华基金<br>广发基金<br>长信基金<br>嘉实基金<br>中欧基金  | 招商基金<br>华安基金<br>华夏基金<br>天弘基金<br>宝盈基金<br>中银基金<br>兴业基金<br>泰康资产   | 华宝基金<br>银华基金<br>泰信基金<br>平安养老<br>银河基金<br>华安证券<br>国投瑞银<br>摩根基金 | 交银施罗德基金<br>东方证券资管<br>景顺长城基金<br>兴证全球基金<br>信达澳亚基金<br>工银瑞信基金<br>中信保诚基金<br>海通证券 |
| 时间              | 2023 年 5 月  |  |  |   |
| 地点              | 公司会议室   |  |  |   |
| 上市公司接待<br>人员姓名  | 董事长、总经理：BI LEI<br>董事会秘书：黄丹红<br>财务总监：林晶晶   |  |  |   |
| 投资者关系活动<br>主要内容 | 公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告已于 2023 年 4 月 26 日依法披露，年报和一季报披露后公司通过多种方式与投资者进行了互动交流。相关交流内容汇总如下：<br><b>1、 公司自主知识产权的电机驱动控制专用内核及控制架构算法情况</b>  |  |  |   |

公司在芯片技术、电机驱动架构、电机技术三个领域均拥有核心优势，并且积累了丰富的知识产权成果。相较于国内 MCU 厂商普遍使用 ARM Cortex-M 处理器内核架构，公司使用拥有自主知识产权的处理器内核架构 ME 内核，专门用于电机控制；得益于自主设计的内核架构，公司可以根据具体终端使用需求进行针对性修改，并且能够实现电机控制算法硬件化，处理复杂、多样的电机控制任务；此外，公司实现了芯片设计的半集成、全集成方案。公司在当前主流的无感算法和电机矢量控制算法上进行了前瞻性研发布局，2022 年度，围绕白色家电、汽车电子、工业控制领域展开技术攻关，针对不同领域开发了相适配的驱动控制算法，帮助下游产业客户解决行业痛点难题，扩大高性能电机的应用领域，为客户产品更新换代提供技术和产品支撑，同时发掘新的电机产品应用市场。

## **2、公司产品下游应用领域表现及应用领域拓展情况**

公司作为专注于高性能 BLDC 电机驱动控制芯片设计公司，产品广泛应用于家电、电动工具、计算机及通信设备、运动出行、工业与汽车等领域。

受国内外宏观经济疲弱、下游消费终端需求乏力、行业周期性调整等影响，2022 年公司面向智能小家电、电动工具、运动出行等既有领域的销售占比由 2021 年的 83.61% 下降至 71.70%。公司 2022 年在新兴领域拓展成效显著，2022 年度白色家电领域销售占比由 2021 年 5.12% 上升至 10.35%，散热风扇（应用于服务器等）领域销售占比由 2021 年 4.38% 上升至 10.42%，白色家电、散热风扇（应用于服务器等）已发展成为公司产品应用的重要领域。

2022 年公司持续发力汽车电子领域的产品研发和市场拓展，车规级产品通过 AEC-Q100 车规认证。2022 年度公司积极与整车厂商或 Tier1 厂商等展开技术交流，全面推广公司的芯片产品和整体应用方案。公司车规产品已进入部分整车厂商或 Tier1 厂商等的可靠性验证后期或小批量试产阶段。汽车电子领域的进入需经历较长的产品导入、方案设计与验证、小批量试产等过程，该领域对产品可靠性要求高，项目验证周期较长，公司将根据汽车电子领域的下游需求持续提供高性能的产品和系统级技术支持，以技术优势稳步推进产品在新兴领域的应用。

## **3、公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营情况**

### **(1) 营业收入**

2022 年，在全体员工共同努力下，公司实现营业收入 32,297.29 万元，较上年同期略有下降 2.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,200.12 万元，较上年同期略有增长 4.98%。

2023 年一季度公司实现营业收入 8,859.99 万元，较上年同期略有增长 1.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,985.18 万元，较上年同期略有增长 4.54%。

### **(2) 毛利率**

公司产品涵盖电机驱动控制的全部关键芯片，包括电机主控芯片 MCU/ASIC、电机驱动芯片 HVIC、电机专用功率器件 MOSFET 等。2022 年度公司综合毛利率整体保持稳定。

### **(3) 存货**

公司采用行业典型的 Fabless 经营模式，芯片生产所需经历的晶圆制造、封装、测试等生产工序均由外部厂商完成，公司自采购获取晶圆原材料入库后到封装测试等委外加工至芯片产品完工，需要一定周期，公司综合考虑产业环境、市场预测及销售需求等因素进行备货。

## **4、研发投入情况**

公司坚持自主研发的技术创新之路，持续加大研发投入力度，对芯片产品技术进行持续的研发创新，公司 2022 年度的研发费用为 6,384.48 万元，同比增加 2,283.70 万元，涨幅 55.69%。此外，公司通过校园招聘与社会招聘相结合进一步加强研发队伍建设，2022 年公司研发人员同比增长 32.73%，研发人员占公司总人数比例为 71.92%。

## **5、专利情况**

公司的核心技术均来源于长期的技术投入和自主创新，拥有独立的知识产权。针对核心技术，公司制定了严格的知识产权保护措施和机制，已形成一套包括专利、非专利技术、商标、软件著作权和集成电路布图设计保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。

截至 2022 年末，公司累计取得境内外专利 106 项，其中发明专利 57 项。

## **6、人才培养和企业文化建设情况**

公司高度重视人才梯队建设，坚持“自主培养、导师制、项目制”的人才

培养战略，通过校园招聘、社会招聘等多种途径引入人才。未来公司将继续吸引高端技术人才加入，形成自主开放、晋升通畅的人才培养体系，建立以核心技术人员为核心，包括研发技术骨干、中层力量、后备力量在内的多层级研发人才梯队。

公司秉承“简单、开放、相信、先行”的价值理念，将企业文化建设作为公司战略发展的重要一环，致力于实现公司和员工的共同成长与发展，为员工职业生涯发展提供机会和平台，激发员工自我提升的内驱力，鼓励员工不断创造、追求卓越，不断丰富和完善员工激励机制，提升员工凝聚力、创造力，促进企业的发展。

#### **7、未来发展展望**

公司将技术研发作为企业发展的重要战略举措，坚持走自主创新的研发之路，在电机驱动控制芯片设计、电机驱动控制架构算法、电机技术三个领域持续深耕，根据智能家电、汽车电子、工业等应用领域的新需求、新变化，开展技术研发，用创新的技术实现高性能的产品，以优异的技术和产品性能推动产品在下游应用领域的深入。

智能家电、汽车电子、工业等是公司产品未来发展的重要应用领域，公司将持续深耕智能家电市场，促进芯片产品进一步深入下游应用，巩固和提升在该领域的竞争优势，同时积极开拓汽车电子、工业等新兴应用市场，稳步推进产品在新兴领域的应用。此外，海外市场拓展也是实现公司战略目标的重要一环，公司将继续推进海外市场布局，拓宽海外市场渠道，发展海外合作伙伴，组建高效技术团队即时响应海外市场需求，推动产品和技术在海外市场的应用推广。

展望未来，公司将围绕着战略目标展开布局，从技术攻关、市场拓展、人才培养等方面着手，推进一系列举措，不断优化经营管理，创造充满活力、创新氛围强的经营环境，促进企业战略目标的实现。